

ETAIN CHIMIQUE à FROID

NOTICE D'UTILISATION

L'étain chimique à froid est un moyen de protection des pistes de cuivre du circuit imprimé et il permet aussi une meilleure soudabilité.

PREPARATION DE SURFACE

Après gravure du circuit imprimé la couche photosensible doit être enlevée à l'aide d'un éliminateur qui va dissoudre complètement la couche et la faire disparaitre. Ne pas utiliser (d'alcool ou d'acétone) pour enlever la couche, cela laisse des traces sur la plaque et empêche une bonne adhérence de l'Etain chimique.

RINCAGE

Il faut ensuite rincer abondamment les plaques en prenant la précaution de ne pas mettre les doigts sur les parties de cuivre.

ETAMAGE

Il faut secouer intensément le bidon et mettre le volume entier (1L) dans une cuvette propre. Tremper ensuite le circuit imprimé directement après rinçage et le laisser environ 15 à 30 secondes dans la cuvette. Un flash de quelques microns va recouvrir la surface. Il faut rincer ensuite les plaques à l'eau (si possible chaude) pour éliminer tous les résidus en surface. Si vous apercevez encore quelques traces rougeâtres c'est que l'étain n'a pas pris sur toute la surface, il faut donc passer un coup de gomme abrasive et refaire l'opération à partir du premier rincage.

Indiquer la date de la première ouverture de votre bidon et considérer qu'entre 4 et 6 mois d'utilisation votre produit a perdu toute son efficacité. En tenant compte bien sûr de la quantité de circuit réalisé.

Dans la réalisation de vos circuits imprimés avec un étamage à froid, en cas de problème, appelez la société BMJ Electronics, un technicien vous viendra en aide.